

2016-2022年中国封装用金属管壳行业发展现状与 十三五盈利前景预测报告

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2016-2022年中国封装用金属管壳行业发展现状与十三五盈利前景预测报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/jinshuzhipin/240298240298.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

金属封装是采用金属作为壳体或底座，芯片直接或通过基板安装在外壳或底座上，引线穿过金属壳体或底座大多采用玻璃—金属封接技术的一种电子封装形式。它广泛用于混合电路的封装，主要是军用和定制的专用气密封装，在许多领域，尤其是在军事及航空航天领域得到了广泛的应用。金属封装形式多样、加工灵活，可以和某些部件（如混合集成的A/D或D/A转换器）融合为一体，适合于低I/O数的单芯片和多芯片的用途，也适合于射频、微波、光电、声表面波和大功率器件，可以满足小批量、高可靠性的要求。此外，为解决封装的散热问题，各类封装也大多使用金属作为热沉和散热片。本文主要介绍在金属封装中使用和正在开发的金属材料，这些材料不仅包括金属封装的壳体或底座、引线使用的金属材料，也包括可用于各种封装的基板、热沉和散热片的金属材料。

经过近几年的发展，我国集成电路封装测试设备生产企业实力得到增强，销售规模不断扩大，产品种类全面发展，新型封装测试设备开发取得了丰硕成果，自主创新产品在生产线上应用，市场需求量大、技术水平较高的设备也开始小批量生产，销售快速增长。目前，国内中、低端封装测试设备制造已达到国外同类产品技术水平，许多企业的产品已形成系列，并取得了许多关键技术专利，国产设备销量不断增大，满足封装测试企业的需求，降低了企业的投资成本，而且服务便利。但在高端设备领域，整体水平相对较弱，市场占有率更小，不利于技术推广和新技术开发。

在全球经济不景气的持续影响下，中国除了移动智能设备增长较为迅速之外，其他产品市场销售多数为稳中有降。在国内外多种因素的制约下，2012年中国集成电路市场销售额在2011年的基础上增幅趋缓，市场规模达到8558.6亿元，增速放缓至6.1%，但市场增速仍大幅高于全球市场。尽管和国外先进水平仍有巨大差距，但我国的集成电路产业有其不可比拟的优势，一是我国的人力资源成本优势，如我国通信设备类企业的人均薪酬仅为欧美企业的三分之一，而且中国的高校还在大量输出这方面的专业人才。对于芯片封装环节，随着芯片复杂度的提高、封装原材料尤其是金丝价格的上扬以及封装方式由低阶向高阶的逐步过渡，芯片封装的成本已经走高。目前金属封装由于价格较高，虽然其性能比较好，但仍只能被广泛用于军事、航空等特殊领域，民用较少，大部分都被塑料封装取代，随着金属封装技术发展，封装成本的进一步缩小，未来一定有更多的民用项目选择金属封装。

中国报告网发布的《2016-2022年中国封装用金属管壳行业发展现状与十三五盈利前景预测报告》内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全

面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

【报告大纲】

第一部分 封装用金属管壳产业深度分析

第一章 封装用金属管壳产品概述

第一节 产品定义

第二节 产品用途

第三节 封装用金属管壳市场特点分析

一、产品特征

二、金属封装外壳分为六种系列

三、金属封装外壳的设计其应用领域

第四节 行业发展周期特征分析

一、行业生命周期理论基础

二、电子封装行业周期

三、封装类型

第二章 封装用金属管壳行业环境分析

第一节 国际宏观经济形势分析

一、世界经济增长有望改善和加快

二、主要国家及地区经济展望

第二节 国内宏观经济形势分析

一、国民经济运行情况

二、工业发展形势

三、固定资产投资情况

四、社会消费品零售总额

五、对外贸易&进出口

第三节 中国封装用金属管壳行业政策环境分析

一、产业政策分析

二、相关产业政策影响分析

第四节 中国封装用金属管壳行业技术环境分析

一、中国封装用金属管壳技术发展概况

二、中国封装用金属管壳产品工艺特点或流程

三、中国封装用金属管壳行业技术发展趋势

第三章 中国封装用金属管壳市场分析

第一节 封装用金属管壳市场现状分析及预测

一、2012-2013年下半年中国封装用金属管壳市场规模分析

二、2016-2022年中国封装用金属管壳市场规模预测

第二节 封装用金属管壳产品产能分析及预测

一、2012-2013年下半年中国封装用金属管壳产能分析

二、2016-2022年中国封装用金属管壳产能预测

第三节 封装用金属管壳产品产量分析及预测

一、2012-2013年下半年中国封装用金属管壳产量分析

二、2016-2022年中国封装用金属管壳产量预测

第四节 封装用金属管壳市场需求分析及预测

一、2012-2013年下半年中国封装用金属管壳市场需求分析

二、2016-2022年中国封装用金属管壳市场需求预测

第五节 封装用金属管壳进出口数据分析

一、2012-2013年下半年中国封装用金属管壳进出口数据分析

二、2016-2022年国内封装用金属管壳产品未来进出口情况预测

第二部分 封装用金属管壳产业结构分析

第四章 封装用金属管壳细分行业分析

第一节 集成电路发展现状

第二节 半导体发展现状

第三节 封装金属材料发展现状

第五章 封装用金属管壳产业渠道分析

第一节 2013年国内封装用金属管壳产品的需求地域分布结构

第二节 2012-2013年下半年中国封装用金属管壳产品重点区域市场消费情况分析

一、华东

二、华南

三、华北

四、西部

第三节 2013年国内封装用金属管壳产品的经销模式

一、企业销售方式的类型及特点:

1. 直销

2. 代销

3. 经销

二、影响企业销售方式的因素

三、影响企业渠道选择的因素

四、企业销售方式及渠道选择策略

第四节 渠道格局

第五节 渠道形式

第六节 渠道要素对比

第七节 封装用金属管壳行业国际化营销模式分析

第八节 企业竞争策略

第三部分 封装用金属管壳行业竞争格局分析

第六章 企业分析可由客户指定企业

第一节 英特尔产品（成都）有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业经营能力分析

四、企业盈利能力及偿债能力分析

第二节 江苏新潮科技集团有限公司

一、企业概况

二、企业子公司主要经济指标分析

三、企业成长性分析

四、企业经营能力分析

五、企业盈利能力及偿债能力分析

第三节 飞思卡尔半导体（中国）有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业成长性分析

四、企业经营能力分析

五、企业盈利能力及偿债能力分析

第四节 威讯联合半导体（北京）有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业成长性分析

四、企业经营能力分析

五、企业盈利能力及偿债能力分析

第五节 南通富士通微电子集团有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业成长性分析

四、企业经营能力分析

五、企业盈利能力及偿债能力分析

第六节 海太半导体（无锡）有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业成长性分析

四、企业经营能力分析

五、企业盈利能力及偿债能力分析

第七节 宏盛科技有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业成长性分析

四、企业经营能力分析

五、企业盈利能力及偿债能力分析

第八节 宁波康强电子股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业成长性分析

四、企业经营能力分析

五、企业盈利能力及偿债能力分析

第七章 封装用金属管壳行业相关产业分析

第一节 封装用金属管壳行业产业链概述

一、半导体产业链

二、产业链模型介绍

第二节 封装用金属管壳上游行业发展状况分析

一、上游原材料生产情况分析

二、上游原材料需求情况分析

第三节 封装用金属管壳下游行业发展情况分析

第四节 未来几年内中国封装用金属管壳行业竞争格局发展趋势分析

第四部分 封装用金属管壳行业投资价值研究

第八章 2016-2022年封装用金属管壳行业前景展望与趋势预测

第一节 封装用金属管壳行业投资价值分析

一、2016-2022年国内封装用金属管壳行业盈利能力分析

二、2016-2022年国内封装用金属管壳行业投资风险分析

第二节 2016-2022年国内封装用金属管壳行业投资机会分析

一、国内强劲的经济增长对封装用金属管壳行业的支撑因素分析

二、下游行业的需求对封装用金属管壳行业的推动因素分析

三、封装用金属管壳产品相关产业的发展对封装用金属管壳行业的带动因素分析

第三节 2016-2022年国内封装用金属管壳行业投资热点及未来投资方向分析

一、产品发展趋势

二、价格变化趋势

三、用户需求结构趋势

第四节 2016-2022年国内封装用金属管壳行业未来市场发展前景预测

一、市场规模预测分析

二、市场结构预测分析

三、市场供需情况预测

第九章 2016-2022年封装用金属管壳行业投资战略研究

第一节 2016-2022年中国封装用金属管壳行业发展的关键要素

一、生产要素

二、需求条件

三、支援与相关产业

四、企业战略、结构与竞争状态

五、政府的作用

第二节 2016-2022年中国封装用金属管壳投资机会分析

一、封装用金属管壳行业投资前景

二、封装用金属管壳行业投资热点

三、封装用金属管壳行业投资区域

四、封装用金属管壳行业投资吸引力分析

第三节 2016-2022年中国封装用金属管壳投资风险分析

一、出口风险分析

二、市场风险分析

三、管理风险分析

四、产品投资风险

第四节 对封装用金属管壳项目的投资建议

一、目标群体建议（应用领域）

二、产品分类与定位建议

三、价格定位建议

四、销售渠道建议

图表目录

图表：UP系列（腔体直插式金属外壳）

- 图表：FP系列（扁平式金属外壳）
- 图表：UPP系列（功率金属外壳）
- 图表：FPP系列（扁平式功率金属外壳）
- 图表：PP系列（平底式功率金属外壳）
- 图表：FO/TO系列（光电器件金属外壳）
- 图表：行业生命周期图
- 图表：产品生命周期特征与策略
- 图表：2009-2014年世界经济增长趋势
- 图表：2009-2014年世界商品贸易增长趋势
- 图表：1990-2012年全球直接投资主要指标
- 图表：2006-2013年国内生产总值及其增长速度
- 图表：2012-2013年国内生产总值增长速度（累计同比）
- 图表：2008-2013年社会消费品零售总额及其增长速度
- 图表：2011-2012年我国集成电路产业实现销售收入
- 图表：2011-2012年我国集成电路销售额占全球比重
- 图表：我国集成电路制造业、设计业、封装业结构
- 图表：我国计算机、通信和其他电子设备制造业主营业务收入
- 图表：我国计算机、通信和其他电子设备制造业主营业务成本
- 图表：我国计算机、通信和其他电子设备制造业资产总计
- 图表：我国计算机、通信和其他电子设备制造业流动资产合计
- 图表：我国计算机、通信和其他电子设备制造业利润总额
- 图表：2016-2022年封装市场规模
- 图表：计算机、通信和其他电子设备制造业企业单位数
- 图表：计算机、通信和其他电子设备制造业固定资产投资额
- 图表：计算机、通信和其他电子设备制造业增加值
- 图表：2012年4月-2014年3月我国集成电路产量
- 图表：计算机、通信和其他电子设备制造业产成品
- 图表：计算机、通信和其他电子设备制造业存货
- 图表：2013年12月各省份集成电路产量
- 图表：2012-2013年下半年中国封装用金属管壳进出口数据
- 图表：2013-2014年我国集成电路实现销售收入
- 图表：2013-2014年我国集成电路实现销售收入
- 图表：近年集成电路销售额情况
- 图表：2013年集成电路出口分季度增长情况
- 图表：2013年集成电路行业投资按月增长

图表：2008-2013年我国集成电路产业投资情况

图表：2013年华东地区基础电路产量全国占比

图表：2013年华南地区集成电路产量全国占比

图表：2013年华北地区集成电路产量全国占比

图表：2013年西部地区集成电路产量全国占比

图表：行业结构类型图

图表：迈克尔波特的五大竞争力量模型

图表：竞争层次图示

图表：成功策略的组成要素图

图表：核心竞争力图

图表：英特尔主要经济指标

图表：英特尔主要利润指标

图表：英特尔主要债务及资产

图表：英特尔主要偿债能力

图表：英特尔主每股收益

图表：英特尔营收情况

图表：英特尔营经费情况

图表：英特尔偿债能力分析1

图表：英特尔偿债能力分析2

图表：新潮集团组织结构

图表：硅穿孔（TSV）封装技术

图表：SiP射频封装技术

图表：圆片级三维再布线封装工艺技术

图表：铜凸点互连技术

图表：高密度FC-BGA封测技术

图表：多圈阵列四边无引脚封测技术

图表：封装体三维立体堆叠技术

图表：50 μm以下超薄芯片三维立体堆叠封装技术

图表：MEMS多芯片封装技术

图表：长电科技近六季度净利润情况

图表：长电科技近六季度主营业务收入情况

图表：长电科技近六季度净利润增长率情况

图表：长电科技近六季度净利润增长率情况

图表：长电科技近六季度成长能力情况

图表：长电科技近六季度存货周转率情况

图表：长电科技近六季度净利润增长率情况

图表：长电科技近六季度净利润增长率情况

图表：长电科技近六季度资金流动比率情况

图表：长电科技近六季度资产负债率情况

图表：长电科技近六季度偿债能力分析数据

图表：长电科技近六季度营业利润率情况

图表：长电科技近六季度净利润增长率情况

图表：长电科技近六季度净利润增长率情况

图表：飞思卡尔半导体总营收及同季度比较

图表：飞思卡尔半导体各产品占比

图表：飞思卡尔半导体主要运营指标

图表：飞思卡尔半导体毛利及增长率

图表：飞思卡尔半导体费用占总营收比

图表：飞思卡尔半导体各产品占比

图表：飞思卡尔半导体毛利率及净利率

图表：飞思卡尔半导体毛利率及净利率

图表：飞思卡尔半导体毛利率及净利率

图表：威讯联合半导体营收情况

图表：威讯联合半导体营收总额

图表：威讯联合半导体营收总额

图表：威讯联合半导体净利润

图表：威讯联合半导体净利润柱状图

图表：威讯联合半导体资金流动情况

图表：威讯联合半导体运营活动所产生现金

图表：威讯联合半导体投资活动所产生现金

图表：威讯联合半导体融资活动所产生现金

图表：威讯联合半导体现金及现金等价物

图表：威讯联合半导体现金及短期投资

图表：威讯联合半导体非现金资产

图表：南通富士通微电子净利润

图表：南通富士通微电子主营收入

图表：南通富士通微电子每股收益

图表：南通富士通微电子净利润增长率

图表：南通富士通微电子净资产增长率

图表：南通富士通微电子成长能力数据

图表：南通富士通微电子存货周转率

图表：南通富士通微电子总资产周转率

图表：南通富士通微电子经营能力数据

图表：南通富士通微电子营业利润率

图表：南通富士通微电子净资产收益率

图表：南通富士通微电子盈利能力数据

图表：南通富士通微电子资金流动比率

图表：南通富士通微电子盈利能力数据

图表：南通富士通微电子偿债能力数据

图表：海太半导体经营方针

图表：海太半导体净利润

图表：海太半导体主营收入

图表：海太半导体每股收益

图表：海太半导体净利润增长率

图表：海太半导体净资产增长率

图表：海太半导体存货周转率

图表：海太半导体总资产周转率

图表：海太半导体营业利润率

图表：海太半导体净资产收益率

图表：海太半导体资金流动比率

图表：海太半导体资产负债率

图表：宏盛科技净利润

图表：宏盛科技主营收

图表：宏盛科技每股收益

图表：宏盛科技净利润增长率

图表：宏盛科技净资产增长率

图表：宏盛科技存货周转率

图表：宏盛科技总资产周转率

图表：宏盛科技营业利润率

图表：宏盛科技净资产收益率

图表：宁波康强电子2013-2014第一季度净利润

图表：宁波康强电子2013-2014第一季度主营收入

图表：宁波康强电子2013-2014第一季度每股收益

图表：宁波康强电子2013-2014第一季度净利润增长率

图表：宁波康强电子2013-2014第一季度净资产增长率

图表：宁波康强电子2013-2014第一季度存货周转率

图表：宁波康强电子2013-2014第一季度总资产周转率

图表：宁波康强电子2013-2014第一季度营业利润率

图表：宁波康强电子2013-2014第一季度净资产收益率

图表：宁波康强电子2013-2014第一季度流动比率

图表：宁波康强电子2013-2014第一季度资产负债率

图表：半导体产业链

图表：十种有色金属日均产量及同比增速

图表：2008-2013年我国集成电路行业增长情况

图表：2013年集成电路出口分季度增长情况

图表：2013年集成电路行业投资按月增长情况

图表：2008-2013年我国集成电路产业投资情况

图表：2016-2022年封装行业平均利润率

图表：2016-2022年金属管壳市场规模

图表详见正文

特别说明：中国报告网所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新，报告发行年份对报告质量不会有任何影响，有利于降低企事业单位决策风险（GY zm）。

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/jinshuzhipin/240298240298.html>